

深圳市联得自动化装备股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券简称：联得装备

证券代码：300545

编号：2026-003

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☒其他_电话会议、券商策略会_
参与单位名称及人员 姓名	一、9月3日 第一场：券商策略会 华源证券、民沅资管、创金合信基金、中泓汇富资管、智联时空共5人 第二场：线下调研 方正证券、平安证券共2人 二、9月4日 第一场：电话会议 中信建投证券、平安资管共5人
时间	2026年9月3日-9月4日
地点	券商策略会现场（深圳）、电话会议
上市公司接待人员 姓名	董事、董事会秘书：刘雨晴女士
投资者关系活动主要内容介绍	一、介绍公司概况 简要介绍公司及子公司发展历程、主营业务、近年主要经营业绩，公司及子公司的核心优势及未来发展规划等情况。 二、投资者会议问答交流 Q1：公司主要客户有哪些？ A1：公司已经拥有一批具有长期稳定合作关系的客户，与包括大陆汽车电子、博世、伟世通、哈曼、京东方、维信诺、深天马、德赛西威、华星光电、苹果、富士康、业成、蓝思科技、惠科等知名企业建立了良好的

紧密的合作关系。

Q2：公司在半导体设备领域有哪些产品和客户？

A2：公司积极布局半导体封测设备业务，已经凭借研发成功的半导体 IC 封装设备顺利切入半导体封测行业。主要产品包括高精度显示芯片倒装键合机、高速共晶固晶机、软焊料固晶机、AOI 检测、引线框架贴膜和检测设备。在先进封装领域，公司有针对性显示驱动芯片键合设备（ILB 设备），该倒装设备是一种采用共晶+倒装的芯片键合工艺的高精度高速度先进封装设备。目前公司半导体设备主要面向国内集成电路、分立器件封测及半导体封装材料领域企业，已与华天科技、厦门通富、安世半导体等企业建立初步合作关系，相关业务尚处于起步阶段，现阶段业务规模较小。

Q3：公司在手机折叠屏领域有哪些产品？

A3：公司柔性 AMOLED 贴合类设备已应用国内外知名终端客户手机折叠屏的量产。公司与国内外多家智能手机知名品牌制造商保持良好的合作关系，持续跟进柔性显示新技术迭代开展技术协同。在折叠屏领域，公司具备深厚的技术储备与成熟量产经验，折叠屏 UTG 超薄柔性玻璃贴附类设备已向行业头部客户实现批量出货，该业务是公司重要的业务方向，有助于公司巩固行业竞争地位，培育新的盈利增长点。

Q4：公司新能源设备方面有哪些布局？

A4：在新能源设备领域，公司已形成覆盖锂电池包蓝膜、固态/半固态电池超声焊接、切叠一体机、电芯装配及 Pack 段整线自动化设备产品矩阵。同时，公司积极布局钙钛矿相关工艺设备的研发，在 GW 级涂布设备、VCD 设备和 HP 设备领域取得关键突破，相关设备已在客户端中试线开展验证运行。后续公司将继续推进新能源设备自动化、一体化、智能化方向研发迭代，持续打磨产品，提升产品竞争力，深化与下游客户的合作。

Q5：公司研发的高精度芯片键合设备的优势是什么？

A5：公司自主研发的全自动高精度芯片键合设备，面向 COC、COS 共晶工艺开发，标准片键合精度可达 $\pm 1 \mu m$ ，集成共晶、银胶双工艺，支持蘸胶、点胶多种作业模式。同一设备可完成两类工艺加工，无需配置两套独立产线，能够帮助客户节约设备投入、提升产品切换效率，可适配光

	通信、激光雷达、传感器等高精度封装应用场景。 Q6：公司今年上半年的研发投入情况以及未来的研发投入重点是什么？ A6：公司的研发投入总额为 5,224.98 万元，占营业收入 8.92%。未来公司将持续保持研发投入力度，重点布局光通讯用 COC/COS 设备，板级封装涂布、ABF 层压、HVCD、热板、贴膜、键合设备等方向，持续强化技术创新能力，把握产业发展机遇，提升公司在光通讯、板级封测领域的综合竞争优势。 Q7：公司是否考虑通过并购重组来扩大经营？ A7：公司一直持续关注产业链相关行业动态，积极寻求整合优质资源的机会，将充分把握中央及地方监管机构支持上市公司并购重组、加强产业整合的政策导向，公司将根据自身发展战略规划、市场需求、行业前景等方面审慎决策。
附件清单（如有）	无
日期	2026-9-4